1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。
3、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利100.080元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本622,303,726股，扣除公司回购专户的股份余额2,096,273股，即620,207,453股，以此计算合计拟派发现金红利100,080,208.00元（含税）。上述事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
8、是否存在公司的优先股情况
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中微公司	688012	不适用

1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘力	胡潇
联系地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
电话	021-61001199	021-61001199
传真	021-61002205	021-61002205
电子信箱	IR@amecnsh.com	IR@amecnsh.com

2、报告期内公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
报告期内，公司主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，公司瞄准世界科技前沿，基于在半导体设备制造产业多年积累的专业技术，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED外延片生产、功率器件、MEMS制造以及其他微观工艺的高端设备领域。
公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。公司MOCVD设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为世界排名前列的氮化镓基LED设备制造商。公司近两年新开发的LPCVD薄膜设备和ALD薄膜设备，目前已有多款新型设备产品进入市场并获得批量订单。
公司主要为集成电路、LED外延片、功率器件、MEMS等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD设备、薄膜沉积设备及其他设备，报告期内，公司主营业务未发生变化。

2.2主要经营模式
1、盈利模式
公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向下游集成电路、LED外延片、先进封装、MEMS等半导体产品的制造公司销售刻蚀设备、薄膜设备和MOCVD设备，提供配件及服务实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体设备产品的销售，其他收入来源于设备相关配件销售及设备安装服务等。
2、研发模式
公司主要采取自主研发的模式。根据公司产品战略规划，公司的研发流程主要包括概念与可行性阶段、Alpha阶段、Beta阶段，量产阶段。
公司按照创新业务、薄膜设备、MOCVD设备等不同研发对象和项目产品，组成了相对独立的研发团队。不同产品研发团队拥有各自独立的机械设计、工艺开发、产品管理和技术支持团队，同时研发人员、研发设备、研发工程等方面资源共用并且可以灵活调配。通过这种研发管理方式，实现了人才、资金等资源在不同的产品及技术服务之间灵活分配，实现共享资源和效率的双赢，使公司能够快速响应不断变化的研发要求，进行持续的技术创新。
3、采购模式
为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度，达到性能资质、研发和设计能力、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期及付款周期等各个标准要求的供应商，才可以被考虑纳入公司合格供应商名录，并定期审核。目前，公司已经与全球众多供应商建立了长期、稳定的合作关系。
4、生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式，实行订单式生产为主，结合少量库存式生产为辅的生产方式。订单式生产是指公司在与客户签订订单后，根据订单情况进行定制化设计及生产制造，以应对客户的差异化需求，库存式生产是指公司对设备通用性标准或试做量出货设备采用相应标准制造而成，主要为快速响应交期及节省客户成本。
5、营销及销售模式
公司采取直销为主的销售模式，国际商用场的客户较为分散，公司在该区域通过代理商模式进行销售。公司设有全球业务部负责公司所有产品的销售管理，下设中国大陆、中国台湾、韩国、日本、新加坡、美洲等国家或区域的销售和支持部门。
2.3所处行业情况
(1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
半导体设备行业是一个全球化程度较高的行业，受经济形势、半导体市场、终端消费市场需求等影响，其发展呈现一定的周期性波动，当宏观经济和终端消费市场需求变化较大时，客户资本开支计划将发生变化，从而对公司的营业收入和盈利产生影响。
全球集成电路和LED方代表的光电子器件的销售额合计占所有半导体产品销售额的90%以上，是半导体产品最重要的组成部分。公司所处的细分行业为半导体设备行业，详细说明请参见“二、报告期主要业务或产品简要情况”之“(一)主营业务情况”。
1、刻蚀和薄膜设备
集成电路设备包括刻蚀设备、封装设备和测试设备等，其细到应设备的市场规模约占集成电路设备整体市场规模的90%。
刻蚀设备是指对晶圆表面的材料进行选择性去除，薄膜设备是指在晶圆表面上沉积各种材料，光刻设备是指将掩膜版上的电路图形转移到晶圆表面上的设备。
随着集成电路芯片特征尺寸的进一步缩小，刻蚀和薄膜沉积设备的重要性日益提升，其中，刻蚀设备是指将掩膜版上的电路图形转移到晶圆表面上的设备。
随着集成电路芯片特征尺寸的进一步缩小，刻蚀和薄膜沉积设备的重要性日益提升，其中，刻蚀设备是指将掩膜版上的电路图形转移到晶圆表面上的设备。
刻蚀，先进逻辑器件工艺节点向5纳米及以下推进，存储器件向3D NAND堆叠层数不断增加，刻蚀设备的需求量和技术难度随之提升。刻蚀设备是指将掩膜版上的电路图形转移到晶圆表面上的设备。
随着集成电路芯片特征尺寸的进一步缩小，刻蚀和薄膜沉积设备的重要性日益提升，其中，刻蚀设备是指将掩膜版上的电路图形转移到晶圆表面上的设备。
刻蚀，先进逻辑器件工艺节点向5纳米及以下推进，存储器件向3D NAND堆叠层数不断增加，刻蚀设备的需求量和技术难度随之提升。